

■ 세부모집분야 】

모집분야	세 부 내 용	
S/W개발	System SW	Bootloader, Kernel & BSP, Driver, AP-CP Interface, System Memory System Analysis, AP Solution 等
	Middleware	Network Framework, Bluetooth, WiFi, NFC, Convergence, GPS, Sensor Hub, RIL, CP Protocol, SDK, FOTA, Server, CD DSP, IMS, Web/Webkit, Engine(Voice/Browser), Multimedia(Codec, 영상처리), Security 관련 소분야 (수학/암호학 포함)
	Application	UX, Phone Application, Network Application, Basic Application, Extended Application, Multimedia, UI Framework 等
	Software Engineering	Process, Tool/Test, SW Management 等
H/W개발	RF	Antenna, BT/WiFi/GPS/DMB/FM, Conduction설계 RF Driver & System, RFIC/PAM 等
	Logic	Audio(음향/음질개선), 모뎀System/Algorithm, Power(전류/Battery), Sensor, Logic회로설계, PCB Artwork설계, ASIC/SoC설계, Camera, LCD/TSP 等
	CAE	PI/SI, RF, EM
	Battery	2차전지, 선행배터리 연구 等
기구,소재 개발	선행/양산 CMF Mechanism, 설계표준, 기구설계, CAE Package/Accessory 재료(금속, 세라믹, Glass), 신소재 等	
디자인	UX Development(UI, GUI, HCI), 제품디자인, 디자인 기획 等	
기타	Healthcare (Sensor 컨트롤, SW플랫폼, 서비스기획, 데이터 분석 等) 기타 Mobile 관련 분야	